香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION
合肥晶合集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年11月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-057

合肥晶合集成电路股份有限公司
关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 11 月 25 日（星期三）至 12 月 1 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@nexchip.com.cn）进行提问。合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 12 月 2 日（星期三）下午 15:00-16:00 以网络文字互动形式召开 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

（一）会议召开时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、执行副总裁、董事会秘书及财务负责人：朱才伟先生

独立董事：盛明泉先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 12 月 2 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 25 日（星期三）至 12 月 1 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@nexchip.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0551-62637000 转 612688

邮箱：stock@nexchip.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日